ペロブスカイト太陽電池のn型半導体電極に関する

ラジカル量・トラップ密度の測定と劣化の関係

戸邉 智之、斎藤 英純、青木 大輔、瓦家正英 (川崎技術支援部 太陽電池評価グループ)

1. 緒言

ペロブスカイト太陽電池(PSC)は、真空プロセスが不要 で溶液塗布・乾燥 による成膜で 20% を超える高い光電 変換効率が得られることから、次世代の太陽電池として注 目されている。しかし、PSC のn型半導体層として使用さ れる TiO₂には、固有の低い電子移動度と紫外線光による トラップの生成という二つの特徴があり、電荷の蓄積、再 結合損失に影響していることが考えられる。これらは、電 流-電圧 (I-V 測定)におけるヒステリシスの発生の要因に なっている可能性がある。また、TiO₂には光触媒反応によ る有機物分解作用があることが知られており、有機物を含 む PSC が分解され、劣化の一要因になっていることが考 えられる。

ペロブスカイト太陽電池の構造を図1 に示す。プラナ ータイプでの電子輸送層にはTiO₂とSnO₂、メソポーラス タイプの多孔質層にはTiO₂が使用されることから、石英 ガラス基板にそれぞれのTiO₂層とSnO₂を作製し、電子ス ピン共鳴法(ESR)を用いたラジカルトラップ法により TiO₂、SnO₂のラジカル量を測定した。また、TiO₂層、SnO₂ の上にペロブスカイト層を作製し、ガラス基板側から光照 射したときのペロブスカイト層結晶変化(劣化状態)を XRDで測定し、ラジカル発生量との関連性を調べた。



(a) プラナータイプ
(b) メソポーラスタイプ
図 1. ペロブスカイト太陽電池の構造

2. 実験

- 2.1 緻密層、多孔質層用材料、ペロブスカイト層材料
 - <緻密層用 TiO₂溶液> M4304(御国色素製) (10nm 粒子分散溶液(固形分率:2.0%))
 - <緻密層用 SnO₂溶液> SnO₂水分散溶液(Alfa Aeser 44592 Tin(IV) oxide, 15% in H₂O colloidal dispersion
 - <多孔質層用 TiO2 溶液> PST-30NRD(日揮触媒化成

製)/エタノール=2/7(固形分率:2.0%)

<ペロブスカイト層用溶液> DMF:ジメチルホルムアミド(東京化成工業㈱) MAI:ヨウ化メチルアンモニウム(東京化成工業㈱) PbI2:ヨウ化鉛(東京化成工業㈱) DMSO:ジメチルスルオキサイド(東京化成工業㈱)

2.2 製膜方法

- ①石英ガラス基板(25 mm×25 mm)をアセトン、イソプロ ピルアルコール、超純水で各10分間超音波洗浄し、エ アブロー乾燥後 UV オゾン処理を20分間行なった。
- ②緻密層用材料、多孔質層用材料をスピンコーティングした。緻密層は、160℃60分、500℃60分の二水準、多孔質層は500℃60分、900℃60分の二水準で焼成した。
- ③ペロブスカイト層用材料をスピンコーティングし、 100℃10分間乾燥した。

2.3 評価方法

- 【ラジカル量】
- ①スピントラップ剤(5,5-dimethyl-1-pyrroline-N-oxide (DMPO))を脱イオン水に希釈する(30倍希釈)。
- ②スピントラップ希釈溶液だけの容器とTiO2とSnO2を 製膜した石英ガラス基板を浸漬した容器にソーラーシ ミュレーター(キセノンランプ)1sun(100mW/cm²) を照射し、それぞれ3分間隔で45分間溶液採取する。
- ③採取した溶液を石英チューブに入れ、ESR 装置(日本 電子製)により、各共鳴ピーク強度比から、各製膜試 料の発生ラジカル量を比較した。

【ペロブスカイト層劣化状態】

ペロブスカイト層を作製した基板のペロブスカイト層 側のXRD 測定を行なった。コントロール基板として、 TiO₂ と SnO₂ を製膜していない石英ガラス基板上にペ ロブスカイト層を作製し、同様のXRD 測定を行なっ た。いずれもソーラーシミュレーター(100mW/cm2) 照射を N₂雰囲気中 25℃で 15 分間行ない、X 線回折パ ターンでの(110)面を示す 20=13.5~14.5°のピーク強 度比で劣化状態を評価した。

【TiO2、SnO2状態】

走査型電子顕微鏡 (SEM) (日本エフイー・アイ製 Scios 製)により、石英ガラス基板上に製膜した TiO₂、SnO₂ の表面状態を観察した。

3. 結果、考察

3.1 ラジカル量評価結果

図2にTiO2緻密層、SnO2緻密層の光照射時間によるラ ジカル発生量変化を示す。TiO2 緻密層の方が SnO2 緻密層 よりもラジカル発生量が多いことが判った。また、TiO2 緻 密層では160℃焼成よりも500℃焼成の方がラジカル発生 量が多くなった。これは、500℃焼成により、溶液中の非 晶質成分が結晶化したことが原因と思われる。



図2. TiO2緻密層、SnO2緻密層の光照射時間 によるラジカル発生量変化

図3にTiO2緻密層とTiO2多孔質層の光照射時間による ラジカル発生量変化を示す。同じ焼成温度(500℃)で緻 密層と多孔質層がほぼ同じラジカル発生量であった。これ は多孔質層の膜厚が緻密層よりも大きいが、多孔質層の粒 子サイズが緻密層より大きいため、全体の比表面積がほぼ 同じになっているためと考えられる。また多孔質層の 900℃焼成では、焼結により粒子サイズが大きくなったこ とで比表面積が小さくなり、ラジカル発生量が少なくなっ たと思われる。



図3. TiO2 緻密層とTiO2 多孔質層の光照射時間 によるラジカル発生量変化

3.2 ペロブスカイト層劣化状態評価結果

図5に各緻密層上のペロブスカイト層 XRD 評価結果を 示す。ピーク強度変化が大きな資料ほど、ペロブスカイト 層の劣化度が大きいと考えられる。TiO2緻密層(500℃焼 成)と SnO₂ 緻密層 (500℃焼成) で大きな差異は認められ ないが、TiO2 緻密層において、焼成温度が160℃の方が劣 化度が小さい。ESR によるラジカル発生量と相関があっ

た。TiO2 緻密層と多孔質層でのペロブスカイト層 XRD ピ ーク強度を図6に示す。明らかに、多孔質層の方が劣化度 が小さい。ラジカル発生量との関連性が見られないが、原 因の一つとして、多孔質層は緻密層より厚いことから光 (紫外線)を多孔質層が吸収することで、その上部のペロ ブスカイト層の光劣化を抑制している可能性がある。



図4. 各緻密層上のペロブスカイト層 XRD ピーク強度





4. 結言

ペロブスカイト太陽電池において、金属酸化物光半導体 として常用される TiO2、SnO2の光照射によるラジカル発 生量を評価し、デバイス劣化挙動との関連性を調べたが、 明確な関連性は確認できなかった。ただし、TiO2多孔質層 のラジカル発生量は大きいにも関わらず、劣化が小さいこ とが判り、今後の高耐久性デバイス開発に役立つ情報が得 られた。

【謝辞】本研究は、公益財団法人東京応化科学技術振興財 団の助成により行ないました。関係各位にお礼申し上げま す。